



H6100P 导热垫片

H6100 是一款导热系数为 10.0 W/m.K 的高导热、低挥发、低渗油导热垫片材料。用于高功率发热器件和散热器或者金属外壳之间，通过有效填充器件之间的不平整或者不规则间隙大幅降低界面之间的整体热阻，实现将发热器件工作时产生的热量快速传导到外界环境中，从而实现控制发热器件工作温度以确保器件安全高效运行。产品推荐使用压缩比例为 15%~60%，推荐设计目标压缩比为 35%。

产品描述

产品特性

条目	描述
外观	灰黑色膏体
厚度 mm	0.5~5.0 (标准的厚度阶梯差为 0.25mm)
工作温度	-50~150℃

产品优点

- 高导热率 10.0 W/m·K
- 低硬度 (Shore oo 30)
- 柔软，低应力
- 低析油率、挥发
- 良好的表面润湿性
- 双面粘性、单面粘性
- 操作便利

典型运用领域

- 5G
- 光模块
- 消费电子
- 新能源汽车
- 大型存储设备
- 电源及半导体



产品典型特性

产品性能

条 目		典型值	备注
密度	g/cm ³	3.36	GB/T 13354
导热系数	W/m・K	10	ASTM D5470
硬度	shore (00)	30	ASTM D2240
压缩比	%	15~60	/
耐击穿电压	V	>2000	ASTM D149 (1.0mm)
体积电阻	Ω*cm	>10 ¹³	ASTM D257
阻燃等级		V0	UL94
热阻特性 VS 压力（厚度 1mm 样品为参考）			
压力（PSI）	10	30	50
热阻（℃.In ² /W）	0.16	0.13	0.1
压缩比例（%）	13.62	24.05	33.90

使用注意

不要让涂布面沾上异物和灰尘。

标准包装

- 标准尺寸 230mm×230mm
- 可根据客户应用尺寸进行模切。

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。防潮，建议储存环境湿度不高 60%。防晒，建议避光储存，存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：8-28℃，存储期 12 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。



注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区诸园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com